

銅張積層板において過去数年間で最大規模となる約 100 億円の設備投資 —半導体パッケージ基板の需要拡大に対応—

昭和電工マテリアルズ株式会社（社長：高橋 秀仁）は、当社の下館事業所および台湾のグループ会社 Showa Denko Semiconductor Materials (Taiwan) Co., Ltd.（以下、SDSMT）において、2025年までに半導体パッケージ基板用銅張積層板の生産ライン・設備を導入し、生産能力を増強します。5G やポスト 5G 社会を支える通信インフラ向け半導体の増加に伴う、半導体パッケージ基板の急速な需要拡大に対応することを目的としており、総投資額は約 100 億円を予定しています。今回の能力増強で、グループ全体の生産能力は従来の約 2 倍に増える見通しです。

新型コロナウイルス感染症の拡大によるリモートワークの浸透や 5G の普及に伴い、データセンターの大型サーバー等で、より膨大なデータを高速で処理することが可能な半導体パッケージの需要が高まっています。

半導体パッケージを構成する基板には、面積の大型化や反り低減のための厚板化が求められ、そこに使用される銅張積層板は、半導体市場の伸びを上回る 115%の成長^{*1}が見込まれています。

当社は、今後のさらなる需要拡大に対応するため、このたび下館事業所および SDSMT に、半導体パッケージ基板用銅張積層板の生産ライン・設備を導入いたします。

下館事業所では、2025 年までに一貫生産ラインを導入します。また SDSMT では、既存の生産ラインの強化のため、一部工程の能力増強を行います。今回の 2 つの設備増強にかかる投資額は総額約 100 億円で、当社の銅張積層板事業の過去数年間における最大規模です。

当社はこれまで、半導体パッケージ基板用銅張積層板を下館事業所、SDSMT、香港のグループ会社 SD Electronic Materials (Hong Kong) Limited で製造していましたが、2021 年からは中国広州のグループ会社 SD Electronic Materials (Guangzhou) Co., Ltd.でも生産を開始し、4 拠点の供給体制を構築しています。今回の投資により、グループ全体における同製品の生産能力はさらに高まり、従来の約 2 倍に増える見込みです。

昭和電工マテリアルズの半導体パッケージ基板用銅張積層板は、反り特性や平坦性などの実装信頼性に優れた点を強みとし、金額ベースで世界トップシェアを有しています（2021 年度）^{*2}。特に、高い実装信頼性が必要なデータセンターで使用されるサーバー等の半導体パッケージでは不可欠な材料とされています。

昭和電工グループは、半導体材料を今後の成長を担うコア成長事業に位置付けています。今回の製品供給体制の強化を通じて半導体の需要拡大に対応するとともに、市場の伸びを上回る成長を目指してまいります。

*1 出典：当社調べ

*2 出典：Prismark Partners, LLC

〈今回の投資を実施する当社拠点およびグループ会社所在地〉

(1) 拠点名 下館事業所
(2) 所在地 茨城県筑西市

(1) 会社名 Showa Denko Semiconductor Materials (Taiwan) Co., Ltd.
(2) 所在地 台湾台南市

以 上

【昭和電工グループについて】

昭和電工グループは、半導体材料において世界トップシェアの製品を数多く持ち、半導体・電子材料の売上高は、全体の3割にあたる約4,000億円に上ります。

2023年1月には昭和電工マテリアルズ株式会社（旧日立化成株式会社）との完全統合、Resonacへの社名変更*を予定しており、半導体分野で高純度ガスからパッケージ材料まで幅広い製品を手掛けています。さらに、国内の半導体材料・装置メーカー各社との共創プラットフォームを生かし、技術革新を加速させることで、グローバル社会の持続可能な発展に貢献してまいります。詳しくは各社ウェブサイトをご覧ください。

昭和電工株式会社 <https://www.sdk.co.jp/>

昭和電工マテリアルズ株式会社 <https://www.mc.showadenko.com>

* 2022年9月下旬に開催予定の臨時株主総会にて承認された場合

◆本件に関するお問い合わせ先

昭和電工株式会社 ブランド・コミュニケーション部 広報グループ 峯田

TEL 080-3606-7538